

证券代码：688432

证券简称：有研硅

公告编号：2025-045

有研半导体硅材料股份公司

关于 2024 年股票期权激励计划

首 次授予部分股票期权注销完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划首次部分已授予但未获准行权的股票期权的议案》，前述董事会审议的注销事项具体情况如下：

根据《有研半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计划(草案)》相关规定，本激励计划首次授予第一个行权期公司层面 2024 年业绩考核达到触发值但未达到目标值，公司层面可行权比例为 80%，部分激励对象因个人考核条件未达成 A 导致不能完全行权，公司及个人考核不达标部分的股票期权合计 75.42 万份。综上所述，公司将注销该部分已授予但考核不达标的股票期权合计 75.42 万份。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研半导体硅材料股份公司关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号 2025-038）。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 2024 年股票期权激励计划合计 75.42 万份股票期权的注销业务已于近日办理完毕。

本次股票期权注销事宜不会影响公司的股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司 2024 年股票期权激励计划的实施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2025 年 12 月 23 日